



# Uttar Pradesh Halbleiterrichtlinie 2024

Abteilung für IT und Elektronik, Regierung von Uttar Pradesh

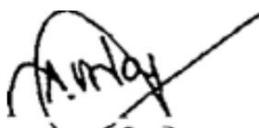
# DISTINATION UTTAR PRADESH

Invest in BIDA



# Inhalt

Präambel.....	3
<b>Vision und Ziel der Politik.....</b>	<b>4</b>
<b>Vision .....</b>	<b>4</b>
2.2 Ziel der Richtlinie.....	4
<b>Führung .....</b>	<b>4</b>
3.1 Knotenagentur.....	4
3.2 Policy Implementation Unit (PIU).....	5
3.3 Ermächtigtes Komitee (EC).....	5
<b>Richtlinienumsetzung und -abdeckung .....</b>	<b>5 4.1</b>
Versicherungsdauer und Versicherungsschutz.....	5
4.2 Zulassungskriterien.....	5
4.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen.....	6
<b>5. Genehmigung und Auszahlung .....</b>	<b>7</b>
5.1 Genehmigungsprozess.....	7
5.2 Auszahlung des Zuschusses .....	7
<b>6. Anreize .....</b>	<b>7</b>
6.1 Steuerliche Anreize .....	7
6.2 Nicht-steuerliche Anreize.....	9
<b>7. Bewerbungsprozess .....</b>	<b>11 8.</b>
Glossar.....	12
9. Abkürzung.....	16

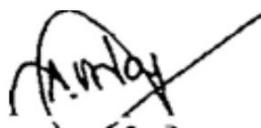
A handwritten signature or mark, possibly reading 'M. May', is written in black ink at the bottom center of the page. It consists of a stylized, cursive script with a long horizontal stroke extending to the right.

## 1 Präambel

Die Halbleiterfertigung ist für den modernen Fortschritt in allen Branchen von entscheidender Bedeutung. Steigerung der Effizienz in Geräten wie Smartphones, Computern und medizinischen Geräten. Es treibt auch Innovationen in den Bereichen KI, IoT und Quantencomputing voran. In wirtschaftlicher Hinsicht fördert es die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wachstum über eine komplexe Lieferkette, während Investitionen technologische Souveränität und globale Wettbewerbsfähigkeit gewährleisten. Im digitalen Zeitalter treiben Halbleiter Innovationen voran. Konnektivität und Wohlstand.

Ziel der India Semiconductor Mission ist es, das Land als globalen Halbleiteranbieter zu etablieren. Die Mission konzentriert sich auf die lokale Produktion, F&D und die Reduzierung der Importabhängigkeit und fördert Innovationen und fortschrittliche Beschäftigungsmöglichkeiten. Durch die Verbesserung der Infrastruktur, die Ermöglichung von Kooperationen und die Förderung qualifizierter Arbeitskräfte fördert die Initiative Indiens technologische Autonomie und globale Stellung in der Halbleiter- und Elektronikbranche. Dies steht im Einklang mit Indiens Bestrebungen nach digitaler Exzellenz und wesentlichen Beiträgen zur globalen Halbleiterlandschaft.

Im Einklang mit der Vision der indischen Regierung widmet sich Uttar Pradesh, eine schnell wachsende Wirtschaft, die etwa 9 % des nationalen BIP ausmacht, der Förderung des Halbleiter-Ökosystems innerhalb des Staates. Dieses Unterfangen soll den Ausbau der Elektronikfertigung und Innovation beschleunigen. Es steht im Einklang mit den Ambitionen des Staates, eine 1-Billionen-Dollar-Wirtschaft zu werden, und steht somit im Einklang mit dem übergeordneten Ziel des ehrenwerten Premierministers, Indien zu einer 5-Billionen-Dollar-Wirtschaft zu machen.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized name or initials, located at the bottom center of the page.

# Vision und Ziel der Richtlinie

---

## 2.1 Vision

Uttar Pradesh als bevorzugtes Ziel für die Halbleiterindustrie zu etablieren, indem eine weltweit wettbewerbsfähige Infrastruktur und ein günstiges politisches Umfeld für die Entwicklung der Halbleiterfertigung als wichtiger Wachstumsmotor für Uttar Pradesh durch den effektiven Einsatz qualifizierter Kräfte, die Anpassung von Innovationen und neue Technologien bereitgestellt werden, die zu einer rundum nachhaltigen Entwicklung führen Ökosystem und trägt so zum Gesamtwachstum der Wirtschaft des Staates und der Nation bei.

## 2.2 Ziel der Richtlinie

Die Hauptziele der Uttar Pradesh Semiconductor Manufacturing Policy sind folgende:

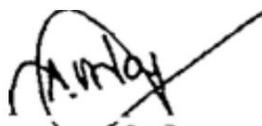
- Aufbau eines robusten Ökosystems für die Halbleiterfertigung in Uttar Pradesh, das bereit ist, das Wirtschaftswachstum des Staates voranzutreiben, Innovationen zu fördern, erhebliche Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und Indiens Eigenständigkeit in einem strategisch wichtigen Bereich zu stärken.
- Entwicklung einer hochmodernen Infrastruktur, die mit fortschrittlichen Design- und Testtools ausgestattet ist und die Zusammenarbeit zwischen Startups erleichtert. Unternehmen und Bildungseinrichtungen, um ihr maximales Potenzial auszuschöpfen.
- Aufbau eines unterstützenden Fabless-Ökosystems innerhalb des Staates mit Schwerpunkt zur gezielten Ausrichtung auf Chipdesign-Unternehmen und Start-ups.
- Aufbau starker Verbindungen zwischen Industrie *und* Wissenschaft  
Förderung eines Pools qualifizierter Talente, der durch Lehrplanverbesserungen, regelmäßige Aktualisierungen der Elektronikausbildung und die Durchführung von Workshops zum Kompetenzaufbau im Rahmen der staatlichen Kompetenzentwicklungsmission erreicht wird.
- Den Weg für ein Umfeld ebnet, das mittel- bis langfristig die Errichtung potenzieller Fertigungseinheiten begünstigt, und gleichzeitig den Schwerpunkt auf *eine höhere Wertschöpfung* bei Halbleiterdesign und Herstellungsprozessen legt.

## 3. Governance

### 3.1 Knotenagentur

UP Electronics Corporation Limited ist eine Knotenagentur der Abteilung of IT& Electronic s, Govt. von Uttar Pradesh wird dafür verantwortlich sein wirksame Umsetzung der Uttar Pradesh Semiconductor Policy 2024.

Die Agentur ist dafür verantwortlich, ein förderliches politisches Umfeld für das nachhaltige Wachstum des Halbleiter-Ökosystems im Staat zu schaffen. Es ist Mühle als zentraler Ansprechpartner für die Zusammenarbeit mit allen Ökosystem-Stakeholdern fungieren. Um den Single-Window-Betrieb zu verwalten, richtet Nodal Agency ein dediziertes Fenster ein Die Projektmanagementeinheit (PMU) ist ausreichend mit ausgelagerten Fachkräften und Beratern ausgestattet, um die Regierung zu unterstützen.



### 3.2 Policy Implementation Unit (PIU)

Eine PIU unter dem Vorsitz des Hauptsekretärs/zusätzlichen Chefsekretärs. Zur Überwachung der Arbeit der Hodal-Agentur wird eine Abteilung für IT und Elektronik eingerichtet. PIU ist für die wirksame Umsetzung der Richtlinie verantwortlich, einschließlich der Abgabe von Empfehlungen an den bevollmächtigten Ausschuss. PIU ist dafür verantwortlich, die Investitionsvorschläge zu prüfen und dem bevollmächtigten Ausschuss zur erforderlichen Genehmigung zu empfehlen.

Dieses Komitee besteht aus Mitgliedern, die von ACS/PS aus der Abteilung für industrielle Entwicklung, der staatlichen Steuerabteilung, Stempel und Registrierung, IT und Elektronik ernannt werden. Finanzen, Wohnungsbau, Arbeit und je nach Bedarf können bei Bedarf Mitglieder anderer Abteilungen/Industrieentwicklungsbehörden usw. hinzugezogen werden.

### 3.3 Bevollmächtigtes Komitee {EC}

Zur Überwachung der wirksamen Umsetzung der Richtlinie wird ein bevollmächtigter Ausschuss auf Landesebene unter dem Vorsitz des Generalsekretärs eingesetzt. Die Satzung des Ausschusses soll sich auf die wirksame Umsetzung der Politik und die abteilungsübergreifende Koordinierung im Hinblick auf die rechtzeitige Lösung von Anlegethemen auf allen Ebenen beziehen. Alle im Rahmen dieser Richtlinie beantragten Projekte unterliegen der Genehmigung durch das ehrenwerte Kabinett auf Grundlage der Empfehlungen des Empowered Committee.

Dieses Komitee besteht aus ACS/PS der Abteilungen für industrielle Entwicklung, staatliche Steuerabteilung, IT und Elektronik, Finanzen, Planung und Kleinindustrie. Kommerzielle Steuer-, Energie-, Bewässerungs-, Wohnungs- und Arbeitsabteilung und je nach Bedarf können bei Bedarf zusätzliche Generalsekretäre/Hauptsekretäre anderer Abteilungen/CEOs von Industrieentwicklungsbehörden usw. hinzugezogen werden.

Das im Rahmen der Richtlinie gebildete ermächtigte Komitee entscheidet über die Erweiterung/Änderung der Richtlinie.

## 4. Umsetzung und Abdeckung der Richtlinien

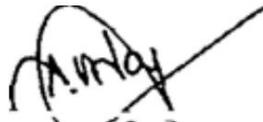
### 4.1 Versicherungsdauer und Versicherungsschutz

Die UP-Semiconductor Policy 2024 ist ab dem Datum ihrer Bekanntgabe fünf (5) Jahre gültig. Die Police deckt das gesamte Bundesland ab. Die Anlage ist ab dem Datum der Bekanntgabe der Police zulässig.

Unternehmen, die von dem Programm profitieren, müssen sich verpflichten, ihren kommerziellen Produktionsbetrieb für mindestens drei Jahre ab dem Startdatum der kommerziellen Produktion des gesamten Projekts aufrechtzuerhalten, und sie müssen eine entsprechende formelle Verpflichtung vorlegen.

### 4.2 Zulassungskriterien

Das Projekt, das im Rahmen eines der folgenden Programme der India Semiconductor Mission (ISM) der indischen Regierung qualifiziert wurde, ist im Rahmen dieser Richtlinie förderfähig.

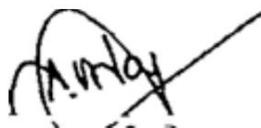


- 4.1.1 Plan zur Errichtung von Halbleiterfabriken in Indien
- 4.1.2 Plan zur Einrichtung von Display Fabs in Indien
- 4.1.3 Plan für die Einrichtung von Anlagen für Verbindungshalbleiter/Silizium-Photonik-Sensoren und Halbleitermontage, -prüfung, -markierung und -verpackung (ATMP)/OSAT-Einrichtungen in Indien.
- 4.1.4 Jedes andere ähnliche System, das von der geändert oder vorgeschlagen wird Indische Regierung.
- 4.1.5 Projekte, die im Rahmen von Design Linked Incentives genehmigt wurden oder sich auf Fab-less-Aktivitäten beziehen, sind im Rahmen dieser Richtlinie nicht förderfähig. Der Investor kann jedoch Vorteile gemäß der UP IT/ITeS-Richtlinie 2022 beantragen und in Anspruch nehmen.
- 4.2 Zulässige Investition
  - 4.2.1 Halbleiterfabriken: Die FiSCdl-Unterstützung als Prozentsatz der Projektkosten ist auf die Aktivitäten beschränkt, die in Abschnitt 2.12 der vom Meity, Government of India, herausgegebenen Richtlinien für ein modifiziertes Schema zur Zerlegung von Halbleiterfabriken in Indien definiert sind 29. Mai 2023, in der jeweils gültigen Fassung. (Glossar 8 (ii))
  - 4.2.2 Display-Fabs: Die steuerliche Unterstützung als Prozentsatz der Projektkosten ist auf die Aktivitäten beschränkt, die in Abschnitt 2.12 der Richtlinien für ein modifiziertes Schema zur Einrichtung von Display-Fabs in Indien von der Meity, Regierung von Indien, vom 29. Mai 2023 definiert sind von Zeit zu Zeit geändert. (Glossar 6 (ii))
  - 4.2.3 ATMP/OSAT: Die steuerliche Unterstützung als Prozentsatz der Investitionsausgaben muss begrenzt sein zu den Aktivitäten, die in Abschnitt 2.1 1 der Richtlinien für ein modifiziertes Programm zur Einrichtung von ATMP/OSAT-Einrichtungen in Indien der indischen Regierung Meity vom 30. Juni 2023 in der jeweils gültigen Fassung definiert sind. (Glossar 8 (iii))

#### **Terms & amp; Bedingungen**

Diese Richtlinie kann nicht mit anderen Richtlinien/Programmen im Staat verzahnt werden. Allerdings ist eine Verzahnung mit den Plänen/Richtlinien der indischen Regierung zulässig. Alle in dieser Richtlinie genannten Anreize können zusätzlich zu den Anreizen in Anspruch genommen werden, die im Rahmen aller Programme/Richtlinien der indischen Regierung verfügbar sind. Von der Regierung angebotene Anreize/ Subventionen unterliegen einer Gesamtobergrenze von 100 % der gesamten förderfähigen Projektkosten, die von der indischen Regierung genehmigt wurden.

Kapitalaufwendungen *oder* Investitionen, die bereits in den Projektkosten des vorgeschlagenen Projekts im Rahmen des geänderten Plans zur Errichtung verschiedener halbleiterbezogener Anlagen berücksichtigt sind. einschließlich Halbleiter-Registerkarten. Display-Fabs, Verbundhalbleiter/Silizium-Photonik-Sensoren-Fabrik, Halbleitermontage, -prüfung, -marmorieren und -verpackung (ATMP). OSAT-Einrichtungen und ähnliche Regierungsprogramme *werden* gemäß den Mitteilungen CG-DL-E-04 102022-239339 vom 04. geändert oder vorgeschlagen. 10.2022, CG-DL-E-06102022-239340 vom 04.10.2022 und CG-DL-E-1006Z023-246449 vom 09.06.2023 haben nur Anspruch auf Kapitalzuschüsse und nicht auf andere in der Police aufgeführte Leistungen.



## 4. Genehmigung und Auszahlung

### 4.1 Genehmigungsprozess:

Es wurden Vorschläge für Initiativen eingereicht, die Halbleiter-Hub, Display- *Herstellung und* Verbindungshalbleiter umfassen. Siliziumphotonik (SiPh), Sensoren (einschließlich MEMS) Fab. Discrete Semiconductors Fab und Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) / Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility in Indien, die von der indischen Regierung der India Semiconductor Mission (ISM) unterstützt wurden und werden die im Bundesstaat Uttar Pradesh verfolgt werden, werden dem Hon'ble State Cabinet zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung des Hon'ble State Cabinet erfolgt auf der Grundlage der Empfehlungen des Empowered Committee.

- Genehmigungsprozess mit GoUP: Die Vorschläge, die von der India Semiconductor Mission der indischen Regierung gebilligt wurden. und der Versuch, Halbleiteranlagen (wie in 4.2.1, 4.2.8 und 4.2.3 definiert) in Uttar Pradesh einzurichten, *erhalten* LOC unter der Bedingung, dass der genehmigte Anreiz 100 % des gesamten förderfähigen Projekts nicht überschreitet Die vom ISM genehmigten Kosten und die ausgestellte LoC werden erst nach Genehmigung des Vorschlags durch die indische Regierung wirksam.
  - Der Antragsteller muss sich gleichzeitig im Rahmen der UP-Semiconductor Policy 2024 bewerben während der Einreichung von Vorschlägen bei der India Semiconductor Mission

### 4.2 Auszahlung des Zuschusses

Der Kapitalanreiz, der zusätzlich zu dem von der indischen Regierung bereitgestellten Anreiz gilt. wird erst ausgezahlt, wenn die indische Regierung ihren Anteil an den Investor freigibt, und die Auszahlung erfolgt im Pari-Passu-Modus.

Alle anderen steuerlichen Anreize. Abgesehen von der Kapitalsubvention sind bei Beginn der kommerziellen Produktion auch eine Rückerstattung der Grundstückskosten sowie die in der Police vorgesehene Befreiung von der Stempelsteuer und den Registrierungsgebühren förderfähig.

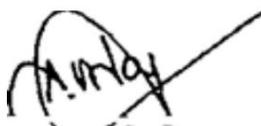
## 6 Anreize

Die im Rahmen dieser Richtlinie angebotenen finanziellen Anreize gehen über die Anreize der indischen Regierung hinaus. Von einer Einheit jedoch geltend gemachte Anreize aus allen Quellen, einschließlich der von der indischen Regierung gewährten Anreize, sofern in der Richtlinie nichts anderes angegeben ist. darf nicht mehr als 100 % der förderfähigen Projektkosten betragen (wie in Abschnitt 4.3 dieser Richtlinie definiert).

### 6.1 Steuerliche Anreize

6.1.1 Kapitalzuschuss: 50 Jahre des von der indischen Regierung genehmigten Kapitalzuschusses. Diese Leistung wird gemäß den von der indischen Regierung im Pari-Passu-Modus bereitgestellten Leistungen ausgezahlt.

6.1.2 Zinssubidiär: Ein Zinsschuss von 5 % pro Jahr (auf den Zinssatz) für Einheiten mit einer Investition von bis zu 200 Cr INR auf das von zugelassenen Banken/Finanzinstituten erhaltene Darlehen wird bis zu einem Höchstbetrag von 1 Cr INR erstattet pro Jahr und Einheit für 7 Jahre (maximal INR 7 Cr pro Einheit)



D. Der Zuschuss wird in Raten von 50 % bei Genehmigung des Projekts, die nächsten 25 % nach 3 Jahren der Genehmigung und die letzten 25 % bei Erreichen der zugesagten Ergebnisse in 5 Jahren gewährt.

### **6.1.1 Kompetenzzentrum (CoE):**

Die Politik sieht vor, eine erstklassige Infrastruktur in Form eines Centre of Excellence (CoE) zu schaffen, um Forschung und Innovation im Halbleitersektor zu fördern. Die Richtlinie zielt darauf ab, in Zusammenarbeit mit renommierten akademischen Institutionen und/oder Branchenverbänden/Industrieverbänden oder anderen staatlichen/privaten Einrichtungen ein Kompetenzzentrum einzurichten. Bis zu 505 % der Gesamtkosten des CoE-Projekts (maximal 10 Cr.) werden von der Regierung von UP getragen

Das Unternehmen muss nur eine Option aus den Absätzen 6.1.9 oder 6.1.10 in Betracht ziehen, nämlich entweder, dass es Zuschüsse für die Einrichtung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums oder eines Exzellenzzentrums in Anspruch nehmen kann

### **6.1.2 Rückerstattung der Patentregistrierungsgebühren: .**

Patentregistrierungsgebühren werden (einmalig) in Höhe von 75% der Kosten erstattet, vorbehaltlich eines Höchstbetrags von 10 Lakh Rupien für den Erwerb inländischer Patente und eines Höchstbetrags von 20 Lakh Rupien für den Erwerb eines internationalen Patents in einer Rate.

### **6.1.3 Industriewohnungen:**

10 Prozent der Kosten für die Entwicklung von Arbeiterunterkünften/Wohnheimen und zugehörigen Gemeinschaftseinrichtungen in einem Umkreis von 10 km um das Gelände der Einheit oder INR 10 crore, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist, werden in 7 gleichen Jahresraten gezahlt.

## **6.2 Nichtsteuerliche Anreize**

6.2.1 Missionskritische Infrastruktur: Die Halbleiterindustrie des Staates wird gemäß dem Essential Services and Maintenance Act (ESMA) als Anbieter wesentlicher Dienste eingestuft.

6.2.2 Wasserversorgung: Landesregierung. wird die Wasserversorgung der Halbleitereinheiten an ihrem Projektstandort sicherstellen.

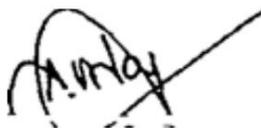
6.2.3 Es ist der Einheit gestattet, über offenen Zugang Strom zu beziehen.

6.2.4 Der Einheit wird Strom für erneuerbare/grüne Energie zur Verfügung gestellt. Die Regelung erfolgt gemäß den ERC-Richtlinien der Electricity Regulatory Commission des Staates.

6.2.5

6.2.6 Die Regierung sorgt für ausreichende Redundanz im Stromnetz, um eine zuverlässige Stromversorgung für den reibungslosen Betrieb von FAB-Projekten zu gewährleisten.

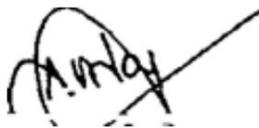
6.2.6 Störungsfreie Bereitstellung: Um eine gesicherte Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Sobald der Entwickler die Investition abgeschlossen und eine Abschlussbescheinigung von der jeweiligen Behörde erhalten und die gesamte Miete vollständig bezahlt hat, ist die Zustimmung des 8. Boards der Behörde eine Voraussetzung für die Aufhebung des Mietvertrags im Falle eines Verstoßes dieser Halbleitereinheiten gegen die Behörde Normen/Satzungen.



6.2.7 Dreischichtbetrieb: Halbleiterbetriebe dürfen rund um die Uhr arbeiten und in allen drei Schichten Frauen beschäftigen, vorausgesetzt, dass die Betriebe die erforderlichen Vorkehrungen im Hinblick auf die Sicherheit weiblicher Mitarbeiter treffen.

6.2.8 Selbstzertifizierungen: Halbleitereinheiten sind gemäß den folgenden Gesetzen und darin festgelegten Regeln von Inspektionen ausgenommen, mit Ausnahme von Inspektionen, die auf einer spezifischen Beschwerde beruhen. Diese Einheiten dürfen Selbstauskünfte in den vorgeschriebenen Formaten einreichen:

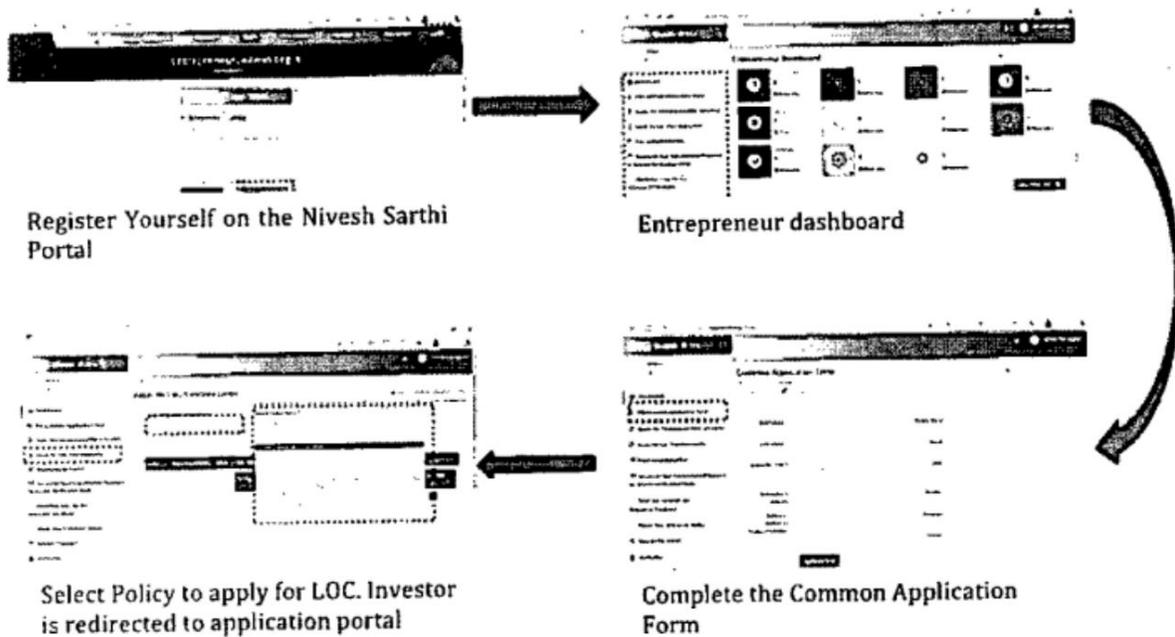
- Das Fabrikgesetz, • Das Mutterschaftsgeldgesetz, • Das Gesetz über Geschäfte und Betriebe
- Das Gesetz über Vertragsarbeit (Regulierung und Abschaffung), • Das Gesetz über die Zahlung von Löhnen, • Das Gesetz über Mindestlöhne

A handwritten signature or mark, possibly a stylized name or initials, written in black ink. It appears to be a signature with a long horizontal stroke extending to the right.

## 7. Bewerbungsprozess

Nivesh Mitra, das Single-Window-Portal von Uttar Pradesh (<https://niveshmifra.up.nic.in/>), ist eine All-in-one-Online-Plattform, die Geschäftsprozesse vereinfacht. Es ermöglicht Online-Bewerbungen, das Hochladen von Dokumenten, Gebührenzahlungen, Live-Statusverfolgung und digital signierte NOCs. Es kümmert sich um die Ausstellung wesentlicher Genehmigungen, Lizenzen, LOCs und NOCs für die Vorgründung, den Vorbetrieb, Erneuerungen und zusätzliche Zertifikate, die für die Gründung und Führung von Unternehmen im Bundesstaat Uttar Pradesh erforderlich sind.

Bewerber müssen ihre Vorschläge über das Nivesh Mitra-Portal einreichen, das sie dann zum Online-Incentive-Management-System weiterleitet. Hier müssten sie wesentliche Angebotsdetails und Dokumente im Zusammenhang mit dem Projekt einreichen, um eine Patronatserklärung (LOC) von der Abteilung für IT und Elektronik im Rahmen der UP-Semiconductor Policy 2024 zu beantragen.



*Amit*

## 8. Glossar

Halbleiterfertigung: Der Prozess der Herstellung von Halbleiterbauelementen, die in verschiedenen elektronischen Produkten verwendet werden.

ich. Zulässige Kapitalinvestitionen für die Einrichtung von Halbleiter- und Display-Fabriken: Wie in Abschnitt 2.12 der Richtlinien für das modifizierte Schema zur Errichtung von Halbleiter-Fabrik (Mitteilungsnummer CG-DL-E-06102022-239339) und den Richtlinien für das modifizierte Schema zur Errichtung von beschriebenen Display Fab (Benachrichtigungsnummer CG-DL-E-06102022-239340) Datei-Nr. W-38/21/2022/PHW vom 29.05.2022

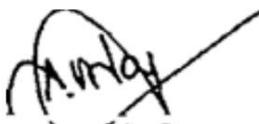
Die Projektkosten umfassen Kapitalaufwendungen/Investitionen

- Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Maschinen, Reinräume, Ausrüstung. und zugehörige Versorgungseinrichtungen
- Forschung und Entwicklung, Technologietransfer
- Andere relevante Kosten wie z. B. Zinsen während des Baus und Versicherungskosten

iii. Zulässige Kapitalinvestitionen für die Einrichtung von Verbindungshalbleitern/Silizium-Photonik/Sensoren-Fabrik/Diskrete Halbleiter-Fabrik und Halbleiter-ATMP und OSAT: Wie in Abschnitt 2.1 1 der Richtlinien für das modifizierte Schema für die Einrichtung von Verbindungshalbleitern/Silizium-Photonik/Sensoren-Fab/ Diskrete beschriebenen Semiconductors Fab und Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT)-Einrichtungen in Indien (im Folgenden als „Plan“ bezeichnet) wurden mit der Mitteilung Nr. CG-OL-E- 06102022- benachrichtigt. 239341 vom 04.10.2022 in der geänderten Fassung, siehe Mitteilung Nr. CG-DL-E- 10062023-

246449 vom 09.06.2023, Aktenzeichen W-38/2 1/2022/IPHW vom 30.06.2023

- Kapitalaufwendungen/Investitionen für Gebäude, Anlagen und Maschinen. Sauber
- Räume, Ausrüstung und zugehörige Versorgungseinrichtungen
- Kapitalausgaben/Investitionen für Forschung und Entwicklung( F&E)
- Kapitalaufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Technologietransfer (ToT)-Vereinbarungen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. D.' with a long horizontal stroke extending to the right.

- Die Ausgaben für Grundstücke, die für das Projekt/die Einheit erforderlich sind, werden nicht bei der Berechnung der anrechenbaren Kapitalaufwendungen/Investitionen im Rahmen des Programms berücksichtigt.

India Semiconductor Mission (ISM): Indian Semiconductor Mission iv. (ISM) innerhalb der Digital India Corporation, Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY), ist die indische Regierung die Knotenstelle für die Umsetzung des Programms/modifizierten Programms für die Entwicklung des Ökosystems für die Halbleiter- und Displayherstellung.

In. Nodal Agency: Die wichtigste Regierungsorganisation, die für die Überwachung zuständig ist  
Umsetzung der Halbleiterpolitik in Uttar Pradesh.

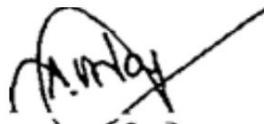
vi. Policy Implementation Unit (PIU): Eine spezialisierte Einheit unter dem Vorsitz des Hauptsekretärs/zusätzlichen Generalsekretärs; Abteilung für IT und Elektronik, verantwortlich für die Überwachung der Arbeit der Nodal Agency.

vii. Bevollmächtigtes Komitee (EC): Ein Komitee auf Staatsebene unter dem Vorsitz des Generalsekretärs, das für die Überwachung der Umsetzung der Richtlinien und die abteilungsübergreifende Koordinierung verantwortlich ist.

viii. Das geänderte Schema für Halbleiterfabriken in Indien wurde am 4. Oktober 2022 vom Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (Meit YN) unter der Gazette-Benachrichtigungsnummer CG-DL-E-04102022-239339 bekannt gegeben.

Das modifizierte Programm sieht eine finanzielle Unterstützung der SOA für die Projektkosten für die Errichtung von Halbleiterfabriken in Indien vor. Die Projektkosten umfassen die Kosten für Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Maschinen, Ausrüstung und zugehörige Versorgungsleistungen. Die finanzielle Unterstützung wird pari-passu nach Genehmigung des Antrags gewährt, vorbehaltlich der in den Programmrichtlinien und im Genehmigungsschreiben festgelegten Bedingungen.

ix. Das geänderte Schema für Display-Fabriken in Indien wurde am 4. Oktober 2022 vom Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (Meit Y) unter der Gazette-Benachrichtigungsnummer CG-DL-E-04102022-239340 gemeldet. Das modifizierte Programm sieht eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 50 % der Projektkosten für die Errichtung von Display-Fabriken in Indien vor. Die Projektkosten umfassen (die Kosten für Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Maschinen, Ausrüstung und damit verbundene Kosten).



Dienstprogramme. Die finanzielle Unterstützung wird pari-passu nach Genehmigung des Antrags gewährt, vorbehaltlich der in den Programmrichtlinien und im Genehmigungsschreiben festgelegten Bedingungen.

X. Das geänderte Schema für Verbindungshalbleiter und ATMP-Anlagen in Indien wurde am 4. Oktober 2022 vom Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie (MeitY) unter der Gazette Notification Number CG DL-E-06102022-239341 gemeldet. Das geänderte Programm für Verbindungshalbleiter- und ATMP-Anlagen in Indien sah eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 50 Prozent der Investitionsausgaben für den Aufbau von Verbindungshalbleitern/Siliziumphotonik/Sensoren/Fabrik für diskrete Halbleiter und Halbleitermontage, -prüfung, -markierung und -verpackung (ATMPJ/ausgelagerte Halbleiter) vor Montage- und Testeinrichtungen (OSAT) in Indien.

Verbundhalbleiter: Halbleitermaterialien, die aus zwei oder mehr Elementen verschiedener Gruppen im Periodensystem bestehen.

Display-Herstellung: Der Prozess der Herstellung von Displays für die Elektronik

Geräte.

Fabless-Ökosystem: Ein Ökosystem, das sich auf das Design und die Entwicklung von Halbleiterchips ohne eigene Fertigungsanlagen konzentriert.

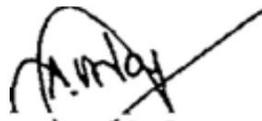
Patronatserklärung (LoC): Ein Finanzinstrument, mit dem einer Partei die Zusicherung gegeben wird, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nachkommen wird.

xv. Pari Passu: Die anteilige Zahlung der Nodal Agency wird freigegeben, nachdem der entsprechende Anteil vom Antragsteller/Projektunternehmen zusammen mit anderen mobilisiert wurde

xvi. Nichtstörungsklausel: Eine Klausel, die die Geschäftskontinuität gewährleistet, indem sie die Genehmigung des Vorstands für die Kündigung von Mietverträgen aufgrund von Richtlinienverstößen erfordert.

xvii. Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Facility: Eine Einrichtung, die Halbleiter-Packaging- und Testdienstleistungen anbietet.

xviii. Halbleiterfertigung (FAB): Der Prozess der Herstellung von Halbleiterbauelementen. auch als Halbleiterfertigung bekannt.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. M. Jay', with a long horizontal stroke extending to the right.

xix. Halbleiterphotonik: Der Zweig der Halbleitertechnologie, der sich mit der Nutzung von Photonen (Lichtteilchen) zur Informationsverarbeitung und -übertragung befasst.

xx. Sonderwirtschaftszone (SEZ): Ein ausgewiesener Bereich, in dem sich die Geschäfts- und Handelsgesetze vom Rest des Landes unterscheiden, um Investitionen anzuziehen und Exporte zu fördern.

XXi-Kapitalzuschuss: Von der Regierung bereitgestellte finanzielle Unterstützung zur Reduzierung der Kapitalkosten, die bei Halbleiterfertigungsprojekten anfallen.

xxii Stempelsteuer: Eine Steuer, die auf juristische Dokumente erhoben wird, insbesondere solche im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Pacht von Grundstücken.

xxiii.Stromsubvention: Ein finanzieller Anreiz, der die Stromkosten für Halbleiterfertigungseinheiten senkt.

xxiv. Stromsteuer: Eine Steuer auf den Stromverbrauch.

xxv. Dual Power Grid Network: Eine redundante Stromversorgungsinfrastruktur, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für Halbleiterfabriken sicherzustellen.

xxvi. Übertragungs- und Transportgebühren: Kosten im Zusammenhang mit der Übertragung und Verteilung von Elektrizität.

xxvii. Gesetz über wesentliche Dienstleistungen und Wartung fESMA7: Rechtsvorschriften, die als bestimmte gelten

Industrien oder Dienstleistungen als wesentlich einzustufen und deren unterbrechungsfreien Betrieb sicherzustellen.

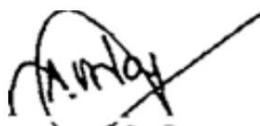
XXViii. Open Access: Die Möglichkeit für Einheiten, Strom direkt vom Netz oder von anderen Anbietern zu beziehen.

xxix. Power Banking: Die Möglichkeit, überschüssige erneuerbare Energie zu speichern und bei Bedarf zu nutzen.

xxx. Einzelfallbasis: Entscheidungen, die individuell auf der Grundlage spezifischer Umstände getroffen werden.

xxxi. Selbstzertifizierung: Der Prozess, mit dem Einheiten die Einhaltung bestimmter Arbeitsgesetze erklären können, ohne dass externe Inspektionen erforderlich sind.

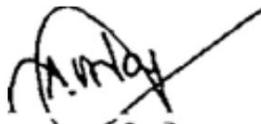
xxxii. Bank/Finanzinstitute: Alle aufgeführten Banken werden berücksichtigt. Berücksichtigt werden alle Finanzinstitute, die von der Reserve Bank of India reguliert und zugelassen sind.

A handwritten signature or mark, possibly 'A. M. D.', written in black ink.

## 9. Abkürzungen

- AI – Künstliche Intelligenz
- ATMP – Montage, Prüfung, Kennzeichnung und Verpackung
- EC – Bevollmächtigter Ausschuss
- EMC – Cluster für Elektronikfertigung
- ESDM – Electronic Systems Design & Manufacturing
- FCI – Anlageinvestitionen
- GOI – Regierung Indiens
- IoT – Internet der Dinge
- IT – Informationstechnologie
- ISM – India Semiconductor Mission
- MeitY – Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie
- OSAT – Outsourced Assembly & Test
- PIU – Projektimplementierungseinheit
- PMU – Projektmanagementeinheit
- SWZ – Sonderwirtschaftszone

HAFTUNGSAUSSCHLUSS Dieses Dokument „Uttar Pradesh Semiconductor Policy 2024“ wurde aus dem Original-Hindi übersetzt, um nicht-Hindi-Benutzern die Arbeit zu erleichtern und eine größere Reichweite zu erreichen. Obwohl größte Sorgfalt darauf verwendet wurde, die Richtigkeit der Übersetzung sicherzustellen, ist im Falle von Unterschieden in der Interpretation der hierin enthaltenen Bestimmungen die „originale“ veröffentlichte Hindi-Version maßgebend.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. Singh', written over a horizontal line.